

2025年度 武田SCRセミナー ULVACドライエッチングセミナー

- 日時： 2025年10月9日（木） 15:00-16:30
- 場所： 東京大学 武田先端知ビル1階 102号セミナー室
(アクセス：https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html)
+ Zoomによるハイブリッド形式
- 講師： (株) アルバック 半導体電子事業本部 上村隆一郎様
同 先進技術研究所 半導体応用技術 谷野健太様
- 参加対象者：エッチング技術に関心がある方
※同業他社の方はお断りをさせていただく場合があります
- 定員： 40名（現地）+ 300名（オンライン）
- 参加費： 無料
- 申し込み： <https://forms.gle/vbL8e4ovK6shX1Fx5>
- 締め切り： 2025年10月6日（月）※定員になり次第、締め切らせていただきます



申し込み用
QRコード

— 講演内容 —

（本講演は日本語のみとなります）

1. アルバックのエッチング源の原理と特徴（ICP, NLD, RIE）
2. 最近のエッチングのトレンドと加工例紹介
3. 最新のアルバックエッチング装置のご紹介
4. 質疑応答

※ 録画はご遠慮ください

※ 上記agendaは予告なしで変更する場合もございますので予めご了承ください。

※ 個別のprocess相談、お困り事のご相談については別途対応いたしますので、当日会場のアルバック担当者までご連絡、リクエストください。

アルバック販売（株） 第1営業部 内藤将太様
同 第3営業部 松澤久博様

お問い合わせ： 東京大学 ナノテク支援室 Tel：03-5841-1506（内線21506）



東京大学マテリアル先端リサーチ
インフラ・データハブ拠点



東京大学
THE UNIVERSITY OF TOKYO



ARIM Japan